

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-061

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于鼎龙（仙桃）半导体材料产业园多晶硅及氮化硅抛光液产品

获得国内主流晶圆厂客户订单的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司—武汉鼎泽新材料技术有限公司（以下简称“鼎泽新材料”）位于仙桃园区年产1万吨CMP抛光液（一期）及年产1万吨CMP抛光液用配套纳米研磨粒子产线自2023年11月竣工试生产后，经过公司高效的投料试产、工艺拉通，以及与客户紧密的验厂稽核、产线验证等工作，目前已具备大批量稳定规模量产能力。近期，经过国内某主流晶圆厂客户严格的产品质量审核，仙桃园区生产的多晶硅(Poly-Si)抛光液及氮化硅(SiN)抛光液产品（搭载仙桃自产研磨粒子）首次取得千万元级批量订单。此外，公司上述抛光液产品在国内其他主流晶圆厂客户同步验证中，目前进展顺利。这是继公司武汉本部CMP抛光液产品在客户端持续放量销售后，在完善扩充公司CMP抛光液产能布局、推动该业务快速增量的重要进展。

目前，公司全制程CMP抛光液产品的市场推广持续进行，多款型号抛光液产品在客户端的订单需求持续上升，铜及阻挡层抛光液、介电层氧化铈抛光液等产品的开发验证预计也将在今年下半年取得进一步突破。

上述订单的执行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因订单的执行而对客户形成依赖。后续公司将及时跟进上述订单的执行情况并履行相应的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年7月9日